

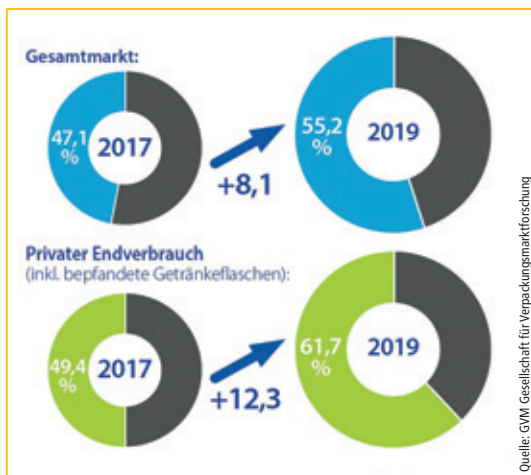
IK: Recyclingquoten für Kunststoffverpackungen gestiegen

Wie die **IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e. V.** berichtet, liegen nun fast zwei Jahre nach Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes die Recyclingquoten für das Jahr 2019 vor. Laut einer Studie der **GVM Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung** ist das Recycling von Kunststoffverpackungen demnach 2019 um 8,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen, im Bereich des privaten Endverbrauchs sogar um 12,3 %. Damit erreichen Kunststoffverpackungen Recyclingquoten von insgesamt 55,2 % bezogen auf den Gesamtmarkt – im Bereich des privaten Endverbrauchs sogar 61,7 % (beteiligungspflichtige Verpackungen und Pfandflaschen). Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen nahm 2019 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 t bzw. 1,2 % ab und

befindet sich auf dem Niveau von 2017. Auch die **Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR)** meldet hinsichtlich der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben Erfolge. Die Vorgabe an die werkstoffliche Verwertung von Kunststoffverpackungen in Höhe von 58,5 % wurde erreicht. Im Unterschied zu den zuvor genannten Recyclingquoten bezieht sich die gesetzliche Quote ausschließlich auf die bei den Dualen Systemen beteiligten Verpackungsmengen. Das Recycling findet zu zwei Dritteln in Deutschland und zu knapp einem Drittel in Europa statt. Weniger als 1 % der Gelbe Sack-Abfälle wird außerhalb Europas exportiert – überwiegend in die Türkei und die Schweiz.

www.kunststoffverpackungen.de

Recyclingquoten bei Kunststoffverpackungen



BASF: Schließung des Standorts Leuna

Die **BASF** wird ihren Produktionsstandort in Leuna schließen und damit das europäische Netzwerk der **Ultramid**-Compoundierung auf drei Standorte in Deutschland konzentrieren. Die Schließung soll bis zum 30. April 2022 abgeschlossen sein. Ins-

gesamt sind rd. 100 Mitarbeiter von der Maßnahme betroffen. Künftig soll die Compoundierung in den verbleibenden Anlagen in Ludwigshafen, Schwarzheide und Rudolstadt erfolgen.

www.basf.com

Technik

Rado: Siliconmischungen chlorfrei und umweltverträglich, genehmigungsfrei und kostengünstig

Die Diskussion um PCB-Emissionen (polychlorierte Biphenyle) bei der Extrusion peroxidisch vernetzter Siliconprodukte ist inzwischen in aller Munde. Behörden und Öffentlichkeit sind bundesweit alarmiert und sensibilisiert. Dies wird letztlich dazu führen, dass Hersteller dieser Produkte auf PCB-emissionsfreie Vernetzungssysteme in ihren Produkten umstellen müssen, da ansonsten das Betreiben ihrer Anlagen nach der 4. BImSchV genehmigungspflichtig werden könnte. Die **Rado Gummi GmbH** aus Radevormwald hat als Spezialist für Siliconcompounds frühzeitig reagiert und die Produktlinie **Radosil-ECF** mit chlorfreiem Vernetzungssystem für peroxidische Siliconcompounds entwickelt. Dabei bleiben sämtliche Produkteigenschaften der zuvor mit DCLBP (2,4-Dichlorbenzoylperoxid) vernetzten Varianten auch mit dem neuen, chlorfreien Initiator vollständig erhalten. Die chlorfreien Radosil-ECF-Mischungen bieten eine ebenso hohe Vernetzungsdichte bei höherer Scorchsicherheit. Weiterhin entstehen im Gegen-

satz zum herkömmlichen System keine Ausblühungen am Fertigteil. Alternativ zur chlorfreien peroxidischen Vernetzung bietet die Rado auch platinkatalysierte (additionsvernetzende) Systeme an, die sich v. a. durch deutliche Produktvorteile wie höherer Bruchdehnung, besserem Weiterreißwiderstand und besserem Druckverformungsrest auszeichnen. Vorteile, die insbesondere bei der Herstellung drucklos extrudierter Schläuche und Profile sowie bei der Kabelbeschichtung zu deutlich verbesserten Produkteigenschaften führen. Wesentliche Produkteigenschaften werden bereits ohne Temperung erreicht. Wie bei Rado üblich, werden auch diese neuen Radosil-ECF-Mischungen zu 100 % in gestraunter, also feinst-filtrierter Ausführung geliefert. Es sind auch hier alle Lieferformen, wie kartonverpackte „Endlos-Streifen“, Rondens, Rundschnüre und Barren, ohne Aufpreis erhältlich. Radosil ist eine geschützte und eingetragene Marke der Rado Gummi GmbH.

www.rado.de

Die Rado Gummi GmbH hat die Produktlinie Radosil-ECF mit chlorfreiem Vernetzungssystem für peroxidische Siliconcompounds entwickelt.

